

10月30日(金) 15:35-17:50

セッションチアマン： 森川 泰宏(株アルバック)・酒井 滋樹(日新イオン機器(株))

◆ 次世代接合技術と装置



ズース・マイクロテック株式会社
ビジネス開発部 ウエハボンディング
部長
石田 博之

[講演要旨]

CMOS イメージセンサー、積層メモリ、MEMS 等で、異種デバイスのインテグレーションが進んでいます。本講演では、実用化が始まっているハイブリッド接合や、検討が進んでいる Collective D2W 接合、及び関連する仮貼り合わせ/剥離技術を紹介します。

[講演者プロフィール]

1988年3月、東北大学大学院修了。同年4月、三菱重工業株式会社に入社。基盤技術研究所に所属し、薄膜形成の表面反応制御の研究開発に従事。2006年、ズース・マイクロテック株式会社に入社。技術開発部、ボンダー部門にてウエハ接合プロセスの開発、および顧客への技術紹介を担当、2017年より現職、現在に至る。

◆ 変える力とつなぐ力で IoT 実装に革命を



コネクテックジャパン株式会社
代表取締役 CEO
平田 勝則

[講演要旨]

拡大する IoT・5G 市場における実装技術課題と、その課題解決に極低温低荷重実装技術 MonsterPAC テクノロジー紹介、及び世界初 10μピッチ FCB 開発状況についてご紹介致します。

[講演者プロフィール]

1964年生まれ。松下電子工業（現パナソニック）入社後、世界初 QFP 鉛フリー化、LGA タイプ CSP

事業化、液晶ドライバー用 TCP・COF 事業化などに取り組む。

リーマンショック後の社会情勢の変化に、実装イノベーションで新たな雇用創出、新市場創出を目指し、2009年コネクテックジャパン株式会社を設立し現在に至る。

◆ 5G 通信への応用可能な特性の実現を目指した LT/Quartz 複合 SAW 基板の作製



早稲田大学
ナノ・ライフ創新研究機構
研究院教授
水野 潤

[講演要旨]

5G 通信に応用可能な SAW 基板の作製を目指し低残留応力な薄膜中間層を用いた LT/水晶接合を達成した。原子層堆積法による成膜技術は、残留応力低減に有用であることが確認され、接合強度・膜質の向上を促進させた。

[講演者プロフィール]

2000 年 7 月 東北大学 博士（工学） 取得

BOSCH 入社後に燃料噴射系ポンプ、コモンレール開発、MEMS センサの開発に従事

2020 年 早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 研究院教授、

浜松医科大学 客員教授

公立諏訪東京理科大学 客員教授

台湾国立中興大学 客員教授

現在に至る

※本講演に興味を持たれた方は、こちらの講演もご覧になっています。

【D-1】 大学セッション ナノテクノロジープラットフォーム

【D-2】 パッケージング市場動向と最新技術動向(FOWLP/ μ LED)